

多因素引发短期波动，行业长期发展向好具有确定性

相关研究：

- 1.《供给短缺叠加需求上行，助推晶圆代工龙头业绩增长》
2021.05.28
- 2.《“缺芯”困局助推国产化替代加速，我国半导体产业或迎机会窗口》
2021.06.29
- 3.《“缺芯”+政策支持，助推国产化替代加速》
2021.08.04

行业评级：增持

近十二个月行业表现



%	1个月	3个月	12个月
相对收益	-14.0	24.9	35.9
绝对收益	-15.9	16.4	35.9

注：相对收益与沪深300相比

分析师：王攀

证书编号：S0500520120001

Tel: (8621) 38784580-8941

Email: wangpan2@xcsc.com

联系人：王文瑞

Tel: (8621) 38784580-8817

Email: wangwr2@xcsc.com

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5层湘财证券研究所

核心要点：

□ 近两周（8月23日-9月3日），申万半导体板块回调，下跌7.57%

近两周（8月23日-9月3日），沪深300上涨1.55%，上证综指上涨4.5%，深证成指下跌0.52%，科创50下跌8.38%。申万电子行业指数下跌3.69%；申万半导体行业指数下跌7.57%，回调较为显著。受宏观经济月度数据不及预期、半导体板块减持、产业链核心企业调价影响上下游利润空间等因素影响，半导体板块估值延续回调态势。截至2021年9月3日，电子行业估值为35.41倍（TTM，剔除负值），半导体行业估值67.32（TTM，剔除负值），回调至近5年中位水平。中长期受益于新技术5G、物联网、智能驾驶等新需求带动，国内政策支持，国产化替代持续推进等因素，行业发展向好的趋势不变。

□ 半导体行业上市公司中期业绩预喜，板块内股东减持频发

2021年度上半期，卓胜微实现归属于上市公司股东的净利润10.14亿元，同比增长187.37%；安集科技实现归母净利润10.68亿元，同比增长44.93%；江丰电子实现归母净利润6063.59万元，同比增长48.5%；兆易创新实现归母净利润7.86亿元，同比增长116.3%；沪硅产业实现归母净利润1.05亿元，实现扭亏为盈；斯达半导实现归母净利润1.54亿元，同比增长90.9%；圣邦股份实现归母净利润2.6亿元，同比增长149.2%；北京君正实现归母净利润3.55亿元，同比增长2994.6%。

神工股份、斯达半导、兆易创新等9家上市公司发布股东减持公告；半导体板块上市公司股东减持公告频发，短期对板块走势产生负面影响。

□ 台积电发布公司最先进的封装技术路线图，并展示了第五代CoWoS封装工艺；先进封装通过芯片在三维空间上的扩展提高芯片的集成度，实现计算性能的优化；后摩尔时代先进封装技术逐渐被推至技术竞争舞台的中央，先进封装的技术演进将带动产业链的技术革新，为上下游企业带来新机遇

台积电致力于先进封装领域研发近10年，Cowos-s工艺竞争优势显著，锁定核心等级的高性能计算（HPC）芯片；chiplet和先进封装等技术开启半导体行业新的时代，成为摩尔到超越摩尔的过渡。

□ 投资建议

建议持续关注半导体行业。2021年度芯片市场需求强劲，供需失衡延续，半导体龙头全年营收上行具备确定性；国家政策支持叠加国产化替代加速，加快国内半导体产业技术研发进展，新技术领域国内龙头积极推进，产业长期发展向好具备确定性。给予半导体行业“增持”评级。

□ 风险提示

晶圆代工企业产能扩产不及预期；市场需求不及预期，国内半导体企业技术研发进展不及预期；内外部宏观政策变化不及预期。

1 半导体行业行情回顾

1.1 多因素扰动，半导体板块估值回调

近两周（8月23日-9月3日），高估值板块回调；沪深300上涨1.55%，上证综指上涨4.5%，深证成指下跌0.52%，科创50下跌8.38%。申万电子行业指数下跌3.69%；申万半导体行业指数下跌7.57%，回调较为显著，在所有二级行业中排序103/104。

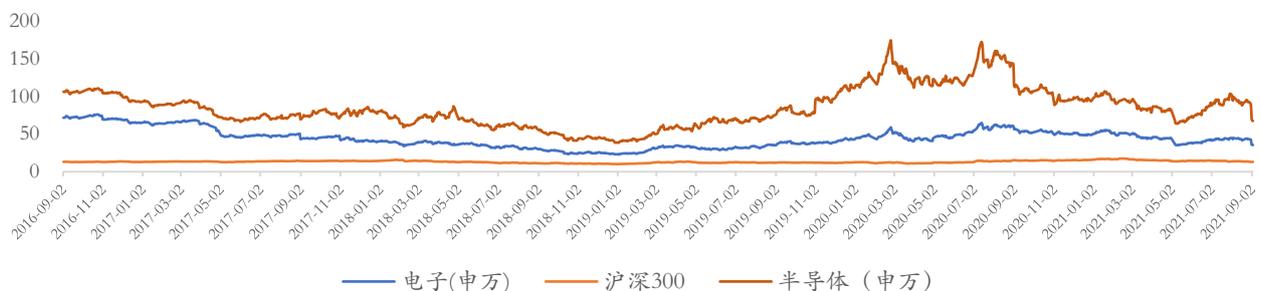
图 1：半导体行业主要指数表现回顾（截至 9.03）

	半导体（申万） （%）	电子（申万） （%）	沪深300 （%）	上证综指 （%）	深证成指 （%）	科创50 （%）
近两周	-7.57	-3.69	1.55	4.50	-0.52	-8.38
年初至今	26.21	6.13	-7.07	3.13	-2.01	0.56

资料来源：wind、湘财证券研究所

受宏观经济月度数据不及预期、半导体板块减持、市场对于半导体行业市场需求景气度延续周期呈谨慎乐观态度、产业链核心企业调价影响上下游利润空间等因素影响，半导体板块估值延续回调态势。截至2021年9月3日，电子行业估值为35.41倍（TTM，剔除负值），半导体行业估值67.32（TTM，剔除负值），回调至近5年中位水平；集成电路子版块估值为61.46，回调幅度显著。中短期受美联储加息进度或放缓，国内政策支持延续；汽车芯片市场缺芯延续，股东减持频发等因素影响，预期半导体板块估值或延续震荡态势。中长期受益于新技术5G、物联网、智能驾驶等新需求带动，国内政策支持，国产化替代持续推进等因素，行业发展向好的趋势不变。

图 2：申万电子行业&半导体行业 5 年 PE(TTM)水平变化（截至 9.03）



资料来源：wind、湘财证券研究所

半导体行业（剔除*ST 盈方，大港股份）71 家上市公司中，12 家上涨，59 家下跌；其中上周涨幅前五位的个股为苏州固锟（31.97%）、帝科股份（27.27%）、国民技术（11.17%）、睿能科技（11.15%）和上海贝岭（9.7%），跌幅后五位的个股为华润微（-15.34%）、赛微电子（-16.61%）、神工股份（-17.43%）、斯达半导（-17.49%）和晶丰明源（-19.14%）。

图 3：半月度半导体行业上市公司涨幅前 5&跌幅前 5（截至 9.03）

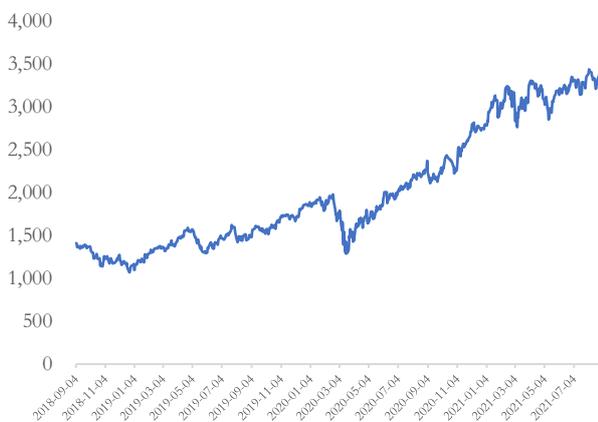
半导体板块个股涨幅前 5				半导体板块个股跌幅前 5			
证券简称	收盘价 (元)	2 周涨幅 (%)	市值 (亿元)	证券简称	收盘价 (元)	2 周跌幅 (%)	市值 (亿元)
苏州固锟	17.38	31.97	140.41	华润微	73.83	-15.43	974.62
帝科股份	108.47	27.27	108.47	赛微电子	29.17	-16.61	212.93
国民技术	31.85	11.17	188.76	神工股份	73.50	-17.43	117.60
睿能科技	15.35	11.15	30.89	斯达半导	316.78	-17.49	506.85
上海贝岭	33.80	9.70	240.93	晶丰明源	388.14	-19.14	240.76

资料来源：wind、湘财证券研究所

1.2 全球重要电子行业市场指数回归至年度高位

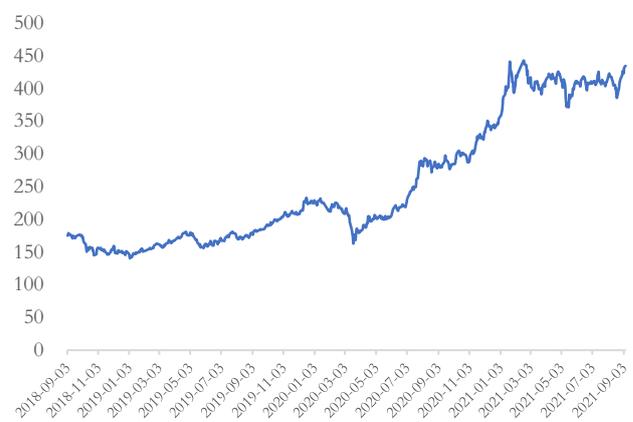
全球半导体行业仍位于景气区间，受美国经济复苏不及预期、加息进度大概率放缓，台积电、三星电子等调价等因素影响，近期费城半导体指数及台湾半导体指数上行。截止 8 月 20 日，费城半导体指数收于 3430.89 点，年同比上涨 53.6%，双周同比上涨 5.2%。台湾半导体指数收于 431.27 点，年同比上涨 51.4%，双周同比上涨 11.8%；行业指数回归至近三年高位。

图 4：费城半导体指数（截至 9.03）



资料来源：wind、湘财证券研究所

图 5：台湾半导体指数（截至 9.03）



资料来源：wind、湘财证券研究所

2 上市公司 2021 年中期业绩公告

【卓胜微】8月23日，卓胜微公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约23.59亿元，同比增长136.48%。公司归母净利润为10.14亿元，同比增长187.37%；扣非后归母净利润约为9.94亿元，同比增长192.42%。公司业绩上行主要受益于（1）5G通信技术的发展带动了射频前端市场需求的快速增长，公司产品在客户端持续渗透。（2）适用于5G新频段的接收端射频模组产品需求持续攀升。

【安集科技】8月25日，安集科技公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约2.83亿元，同比增长47.6%。公司归母净利润为7218万元，同比增长44.93%；扣非后归母净利润约为3443.6万元，同比下滑29.72%。公司剔除股权激励带来的股份支付费用后，归母净利润为9584.73万元，同比增长83.61%；扣非后归母净利润约为5810.2万元，同比增长13.05%。报告期内公司加速建立核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，并保障长期供应的可靠性。在化学机械抛光液板块，公司全资子公司安集投资已与国内具备优质研发及生产资质的合作伙伴共同投资设立山东安特纳米材料有限公司，已开展实质性合作，并积极建立关键原材料硅溶胶的自主可控生产供应能力。在功能性湿电子化学品板块，公司通过自建、合作等多种方式，加强产品及原料的自主可控。

【富瀚微】8月25日，富瀚微公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约7.18亿元，同比增长154.37%。公司归母净利润为1.39亿元，同比增长215.67%；扣非后归母净利润约为1.35亿元，同比增长215.39%；公司营收上涨主要受益于下游需求回暖（1）专业安防市场，国内智慧城市、雪亮工程、智能楼宇、智慧消防等项目开展带来增长动能。（2）新兴智能化应用的出现，无线、低功耗产品市场增长；（3）汽车领域电动化、智能化、网联化和共享化的产业转型升级的大背景下，汽车电子市场需求提升；（4）公司核心技术成果转化效果显著，有效驱动公司业绩成长。

【睿能科技】8月25日，睿能科技公告披露2021年半年度业绩，公司半年度营收达约10.57亿元，同比增长57.28%。归母净利润为5.99亿元，同比增长320.66%；扣非后归母净利润约为5.63亿元，同比增长1136.75%。

【晶盛机电】8月26日，晶盛机电公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达22.88亿元，同比增长55.55%，公司半年度归母净利润为6亿元，同比增长117.23%；扣非后归母净利润为5.45亿元，同比增长112.5%。公司业绩上行主要受益于（1）碳中和背景下国内光伏行业的快速发展以及大尺寸硅片推动的技术升级驱动，光伏硅片厂商扩产推高设备需

求；(2) 全球半导体需求回归高景气，下游需求旺盛带动上游硅片产能紧缺，加速半导体硅片设备的国产化进程；(3) 蓝宝石领域，受益于 LED 和消费电子行业的需求增长，蓝宝石材料需求量持续快速增加。

【帝科股份】8月26日，帝科股份公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达13.95亿元，同比增长179.38%，公司半年度归母净利润为6826.64万元，同比增长41.38%；扣非后归母净利润为5930.36万元，同比增长170.9%。公司业绩上行的驱动因素来源于(1) 应用于导电银浆的导电银浆出货量提升，应用于N型电池、IBC电池的新产品处于规模化量产出货阶段；(2) 半导体电子封装用导电粘合剂产品稳健推进从小客户验证到中大客户放量的既有策略，推进客户结构升级，提升行业影响力。

【江丰电子】8月26日，江丰电子公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约7.23亿元，同比增长35.68%。公司归母净利润为6063.59万元，同比增长48.49%；扣非后归母净利润约为4021.4万元，同比增长12.46%。公司业绩上行主要受益于移动、数据中心和云计算服务器、汽车和工业市场的5G连接、人工智能、深度学习、虚拟现实和其他新兴应用的激增，带动芯片上游原材料超高纯溅射靶材需求的持续增长；国产化替代进程加快带动公司销量上行，公司新产品精密零部件产品已经广泛用于PVD、CVD、刻蚀机等半导体设备，在多家企业实现量产交货。

【力合微】8月26日，力合微公告披露2021年半年度业绩，公司半年度营收达约1.39亿元，同比增长201.4%。归母净利润为1619.72万元，同比增长6.94%；扣非后归母净利润约为977万元，同比下滑24.73%。

【兆易创新】8月27日，兆易创新公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达36.41亿元，同比增长119.62%，公司半年度归母净利润为7.86亿元，同比增长116.32%；扣非后归母净利润为7.4亿元，同比增长137.6%。公司业绩上行主要是由于公司芯片产品市场需求增加，各业务产品线收入均有所增加；其中存储器业务增加约12.83亿元，微控制器业务增加约5.5亿元，传感器业务增加约1.48亿元。

【中芯国际】8月27日，中芯国际公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约160.9亿元，同比增长22.3%。公司归母净利润为52.41亿元，同比增长278.1%；扣非后归母净利润约为23.39亿元，同比上涨331.6%。公司业绩上行的市场动能主要来自于(1) 稳固的市场存量需求；(2) 新兴技术发展引发的增量需求；(3) 疫情带来的在地生产需求增量，部分公司停产导致的需求上行；地缘政治紧张引发的国产化替代。

图 6：中芯国际 2021 年 H1 营收简析

业务类型分类			
业务	营收 (亿元)	营收占比	业务增速 (同比)
晶圆代工	145.05	91.5%	23.2%
光掩模制造、测试及其他	13.48	8.5%	15.7%

技术节点分类		
节点	营收占晶圆代工比例	增速 (同比)
90 纳米及以下制程	61.4%	32.5%
55/65 纳米	31.2%	22.8%
FinFET/28 纳米	11.1%	62.3%

资料来源：wind，湘财证券研究所

【沪硅产业】8月27日，沪硅产业公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达11.23亿元，同比增长31.44%，公司半年度归母净利润为1.05亿元，实现扭亏为盈；扣非后归母净利润为-7652万元，亏损大幅降低。公司业绩上行主要系因半导体市场需求旺盛及公司产能攀升，产量大幅增加所致，公司200mm及300mm硅片业务收入均有所增长。

【苏州固锴】8月29日，苏州固锴公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达12.08亿元，同比增长67.31%，公司半年度归母净利润为1.15亿元，同比增长146.92%；扣非后归母净利润为1亿元，同比增长185.04%。公司业绩上行主要原因为单晶PERC银浆性能上取得突破，数家客户完成可靠性测试后逐渐上量，市场需求释放期会延续到下半年。下半年除了单晶PERC银浆销售继续快速增长外，HJT低温银浆和单晶PERC背银将会是新的增长点。

【斯达半导】8月29日，斯达半导公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约7.19亿元，同比增长72.62%。公司归母净利润为1.54亿元，同比增长90.88%；扣非后归母净利润约为1.42亿元，同比上涨105.13%。公司业务营收在工业控制和电源行业、新能源行业、变频白色家电等领域都实现了稳步增长。

【欧比特】8月29日，欧比特公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约3.29亿元，同比下滑3.7%。公司归母净利润为3251.9万元，同比增长3.33%；扣非后归母净利润约为2345万元，同比上涨23.5%。公司业务营收在工业控制和电源行业、新能源行业、变频白色家电等领域都实现了稳步增长。

【立昂微】8月29日，立昂微公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约10.28亿元，同比增长58.57%。公司归母净利润为20897

万元，同比增长 174.21%；扣非后归母净利润约为 18386 万元，同比上涨 234%。公司业绩上行主要系半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片产品的市场需求旺盛，公司产品量价齐升，市场占有率稳步提升。

【圣邦股份】8 月 29 日，圣邦股份公告披露 2021 年半年度业绩，公司 2021 年半年度营收达约 9.15 亿元，同比增长 96.66%。公司归母净利润为 2.6 亿元，同比增长 149.16%；扣非后归母净利润约为 2.25 亿元，同比上涨 121.41%。公司业绩上行主要受益于公司模拟芯片产品销量上行。

【北京君正】8 月 30 日，北京君正公告披露 2021 年半年度业绩，公司 2021 年半年度营收达约 23.36 亿元，同比增长 558.46%。公司归母净利润为 3.55 亿元，同比增长 2994.8%；扣非后归母净利润约为 3.37 亿元，同比上涨 3132.18%。公司业绩上行系各产品线市场需求旺盛提振公司收益，同时，北京矽成自 2020 年 5 月 31 日开始纳入合并范围。

【北方华创】8 月 30 日，北方华创公告披露 2021 年半年度业绩，公司 2021 年半年度营收达约 36.08 亿元，同比增长 65.75%。公司归母净利润为 3.1 亿元，同比增长 68.6%；扣非后归母净利润约为 2.25 亿元，同比上涨 127.62%。公司业绩上行系半导体和光伏行业持续景气，公司工艺装备和电子元器件业务发展态势良好。

图 7：上市公司 2021 年中期业绩梳理

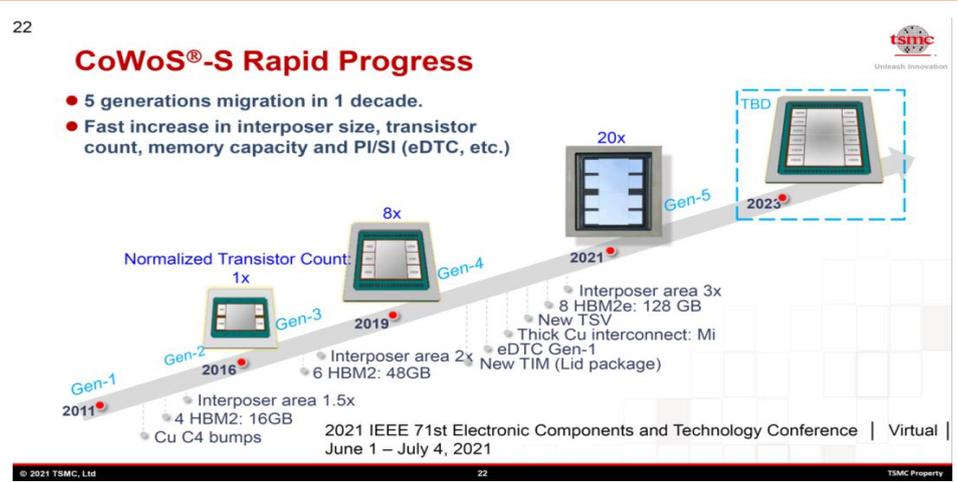
	归属于母公司/上市公司股东的净利润	同比涨幅
卓胜微	10.14 亿元	187.37%
安集科技	7218 万元	44.93%
富瀚微	1.39 亿元	215.67%
睿能科技	5.99 亿元	320.66%
晶盛机电	6 亿元	117.2%
帝科股份	6826.64 万元	41.4%
江丰电子	6063.59 万元	48.5%
力合微	1619.72 万元	6.9%
兆易创新	7.86 亿元	116.3%
中芯国际	52.41 亿元	278.1%
沪硅产业	1.05 亿元	扭亏为盈
苏州固锴	1.15 亿元	146.9%
斯达半导	1.54 亿元	90.9%
欧比特	3251.9 万元	3.3%
立昂微	20897 万元	174.2%
圣邦股份	2.6 亿元	149.2%
北京君正	3.55 亿元	2994.8%
北方华创	3.1 亿元	68.6%

资料来源：wind，湘财证券研究所

3 半导体行业事件点评

HotChips33 年度会议，台积电介绍了公司最先进的封装技术路线图，并且展示了为下一代小芯片架构和内存设计做好准备的最新一代 CoWoS 解决方案。据悉 AMD MI200“Aldebaran”GPU 使用 TSMC 第 5 代 CoWoS 封装工艺。

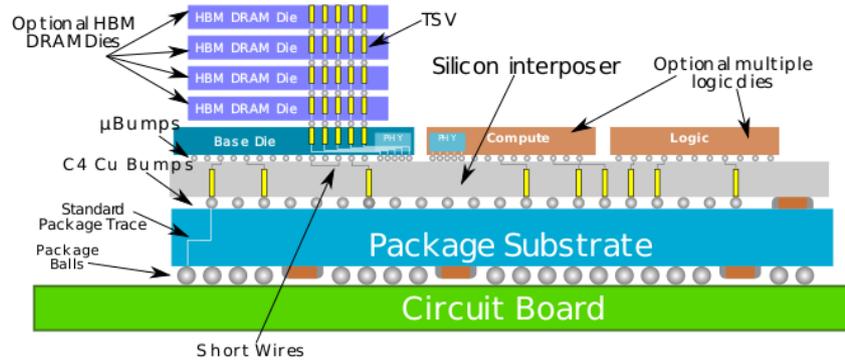
图 8：台积电 CoWoS-S 封装技术路线图



资料来源：TSMC，湘财证券研究所

台积电积致力于先进封装领域研发近 10 年，Cowos-s 工艺竞争优势显著，锁定核心等级的高性能计算 (HPC) 芯片：CoWos (chip on wafer on substrate) 是 2.5D 后道先进封装的一种，其先将芯片通过 chip on wafer(Cow)的封装制程将芯片通过焊锡凸块连接至晶圆，再将 CoW 芯片与基板 (Substrate) 连接，整合形成 CoWoS。CoWos 封装将多个芯片通过硅中介层 (silicon interposer) 互联，集合了多个不同的 chip。提升了模块集成度及计算性能，有效降低封装体积及模块功耗。台积电致力于先进封装的研发已有 10 年，其 CoWoS 封装制程主要锁定核心等级的高性能计算 (HPC) 芯片，为台积电特有的技术。台积电拟于今年发布的第五代 CoWos-S 相比 2016 年的第三代技术性能显著提升，CoWoS-S 的晶体管数量将增加 20 倍。第五代封装技术还将封装 8 个 128G 的 HBM2e 内存和 2 颗大型 SoC 内核；且采用了更厚的金属层 (5Mi)、eDTC*和 HBM2e, 预计芯片计算性能将进一步提高。AMD MI200“Aldebaran”GPU 将率先使用第五代 CoWos-S 封装工艺。

图 9: COWOS-S 封装工艺图示



资料来源：维基百科，湘财证券研究所

chiplet 和先进封装等技术开启半导体行业新的时代，成为摩尔到超越摩尔的过渡：后摩尔时代摩尔定律定律演进放缓，半导体工艺节点逐渐接近物理极限，每一代半导体工艺节点提升对于芯片性能带来的收益通常在 15% 左右，但相应的成本支出却大幅上升。先进封装通过芯片在三维空间上的扩展提高芯片的集成度，实现计算性能的优化；AI 时代对于算力的需求与日俱增，先进封装技术逐渐被推至技术竞争舞台的中央，三星、台积电、英特尔、中芯国际、长电科技、通富微电等头部企业均在积极部署先进封装领域；先进封装的技术演进势必带动产业链上下游的技术革新，如导热界面材料、光刻掩模板、高性能内存技术、EDA 工具等。

4 半导体行业动态汇总

4.1 半导体行业技术新动态

【三星宣布推出 SmartThings Edge 架构，面向智能家居领域】

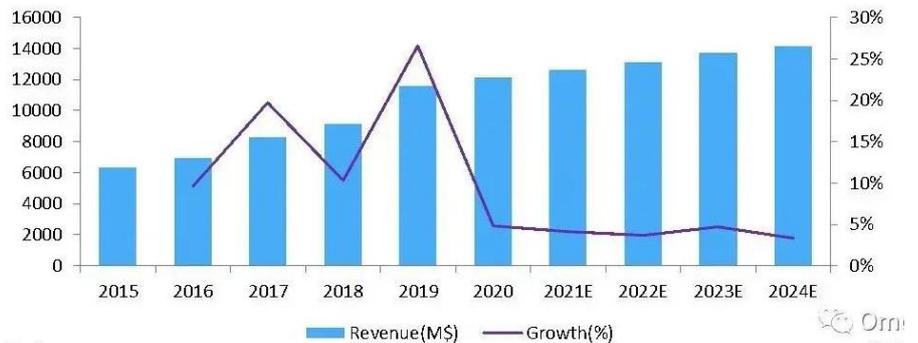
8 月 22 日，三星宣布推出 SmartThings Edge，SmartThings Edge 是一种面向智能家居领域新的架构，它允许智能家居产品的核心功能在本地网络上执行，而不是依赖于云处理。这一新功能消除了对基于云的处理的需求，这意味着许多流程可以在 SmartThings Hub 上本地完成。用户还可以添加基于 LAN、Zigbee 和 Z-Wave 的设备。SmartThings Edge 支持 SmartThings version 2 和 version 3，以及 Aotec 的部分较新的 hubs。此外，三星还为 Matter 提供支持，Matter 是一个开源智能家居平台，该平台也得到了亚马逊、苹果和谷歌的支持。

4.2 半导体行业新闻

【2021 年全球手机 CIS 的销售额将超 126 亿美元】 omdia

8 月 23 日，Omdia 数据显示，智能手机的影像能力依旧是各大手机厂商比拼的重点。作为手机影像系统的核心元件，CIS 市场经历了近十年的高速增长。Omdia 预测，2021 年全球手机 CIS 的销售额将达到 126 亿美元，较 2015 年的 63 亿美元翻了一番。随着智能手机市场的日趋饱和，未来手机 CIS 的市场增速逐渐放缓。预计 2022，2023，2024 年，手机 CIS 市场的增长率分别降至 3.6%、4.7%和 3.4%。在头部手机厂商的推动下，CIS 的分辨率不断提高，像素尺寸不断缩小，画幅尺寸不断扩大。多像素合一、快速对焦、叠加高动态范围 HDR 等技术，将持续推升手机 CIS 芯片的 ASP。

图 10：智能手机 CIS 销售额



资料来源：omdia，湘财证券研究所

【Digitimes 预期 4G 芯片将开始涨价】 Digitimes

8 月 23 日，Digitimes 称多位业内人士表示，下半年适用于移动设备的 5G 调制解调器、射频芯片的价格将会下降，而 4G 基带芯片价格将会小幅上涨。目前全球主要的半导体厂商都将重点放在 5G 芯片的制造上，随着规模效应，这类芯片的价格逐渐降低。基于世界多数地区的 5G 建设还相对较缓慢，因此 4G 手机依旧有着大量的需求。Digitimes 表示，4G 手机能够为海外经销商带来更大的利润空间，因此 4G 芯片的需求依旧十分大，供不应求导致 4G 芯片的价格有所上涨。

【TrendForce: DRAM 总产值 Q2 达 241 亿美元，三星、SK 海力士、美光营收前三】 全球半导体观察

8 月 23 日 TrendForce 发布报告称，第一季度 DRAM 价格正式反转向上下后，需求端为避免陷入后续价格更高及货源不足的情况，于第二季度加大采购力道。报告指出，DRAM 报价方面涨幅则较第一季度扩大，在出货量与报

价同步走升的情况下，推升第二季度整体 DRAM 总产值达 241 亿美元，季增 26%。

TrendForce 预计，第三季度平均合约价仍将上扬，涨幅收敛至 3%-8%。2021 年第二季度全球 DRAM 厂商自有品牌内存营收排行方面，三星、SK 海力士与美光位列前三位，营收涨幅均超过两成。

图 11：2021Q2 全球 DRAM 厂营收

Ranking	Company	Revenue			Market Share	
		2Q21	1Q21	QoQ	2Q21	1Q21
1	Samsung	10,510	8,070	30.20%	43.60%	42.00%
2	SK hynix	6,720	5,562	20.80%	27.90%	29.00%
3	Micron	5,448	4,444	22.60%	22.60%	23.10%
4	Nanya	809	631	28.20%	3.40%	3.30%
5	Wimbond	238	171	39.10%	1.00%	0.90%
6	PSMC	65	60	7.20%	0.30%	0.30%
	Others	325	258	25.80%	1.30%	1.30%
	Total	24,114	19,197	25.60%	100.00%	100.00%

备注1：1Q21--1美元兑换1,115韩圆；1美元兑换28.1台币
备注2：2Q21--1美元兑换1,121韩圆；1美元兑换28.0台币

资料来源：Trendforce，湘财证券研究所

【AFS：芯片短缺加剧，全球汽车预计减产超 810 万辆】TechSugar

9月5日 Auto Forecast Solutions（简称为 AFS）最新数据称，因全球汽车芯片短缺加剧，截至 8 月 29 日，全球汽车累计减产 688.7 万辆，较上周增加 44.5 万辆，AFS 同时预测今年汽车将减产 810.7 万辆。而在 8 月中旬，AFS 推测的这一数字仍为 710 万辆。根据 AFS 预测，未来 4 个月，全球仍将减产汽车 121.9 万辆。

图 12：汽车减产分区域预测

区域	预计减产汽车规模（万辆）
北美洲	246.5
欧洲	229.3
中国	166.6
亚洲其他国家	133.6
南美洲	28.5
中东&非洲	6.2

资料来源：TechSugar，湘财证券研究所

【Trendforce： 二季智能手机产量达 3.07 亿支,同比增长 10%】 全球半导体观察

TrendForce 发布二季度智能手机产销率数据, 2021 年第二季度智能手机达 3.07 亿支, 同比 2020Q2 上涨 10%; 环比 2021Q1 下滑 11%, 系受疫情扰动。总计今年上半年合计生产总数为 6.52 亿支, 较去年同期疫情爆发之初成长近 18%。 第二季为苹果 (Apple) 新旧机款交替的过渡期, 是全年季度生产表现上相对低迷的季度, 故列居第四名, 生产量约 4200 万支。

图 13: 2021Q2-2021Q3 全球前六大智能手机品牌市占率预估

公司	2021Q2		2021Q3 E	
	排名	市占率	排名	市占率
三星	1	19%	1	20.3%
OpPO	2	16.1%	3	15.2%
小米	3	16.1%	4	15%
Apple	4	13.7%	2	15.8%
Vivo	5	11.1%	5	10.6%
传音	6	6.3%	6	5.6%
总产量 (百万台)	307.4		329.9	

资料来源: Trendforce, 湘财证券研究所

【瑞萨完成收购 Dialog, 稳坐嵌入式解决方案龙头地位】 全球半导体观察

8 月 31 日, 瑞萨宣布, 已完成对英商 Dialog 的收购, 总股权价值约 48 亿欧元。瑞萨电子将结合 Dialog 的低功耗混合信号产品、低功耗 Wi-Fi 和蓝牙连接专业知识、闪存、电池和电源管理以及其长期存在的产品组合, 以更广泛的产品组合扩大其市场占有率。瑞萨预计, 合并后的公司将带来约 2 亿美元的收入增长, 运营效率可节约 1.25 亿美元的成本费用。瑞萨总裁兼首席执行官 Shibata 表示, 合并后的公司将致力于利用一系列不断增长的机遇, 包括物联网、工业和汽车领域。

4.3 上市公司动态

【中芯国际】 9 月 3 日晚间, 中芯国际发布公告宣布公司董事长及董事会提名委员会主席变更, 公司执行董事、首席财务官兼公司秘书高永岗博士, 获委任为本公司代理董事长, 履行董事长职责, 并担任董事会提名委员会主席。原董事长兼执行董事周子学博士因个人身体原因, 辞任本公司董事长及董事会提名委员会主席的职务。

【中芯国际】 9 月 3 日午间, 中芯国际披露与临港管委会签订合作框架协议事宜; 中芯国际和上海自贸试验区临港新片区管委会有意在上海临港自贸区

共同成立合资公司，合资公司将规划建设产能为 10 万片/月的 12 英寸晶圆代工生产线项目，聚焦于提供 28 纳米及以上技术节点的集成电路晶圆代工与技术服务，项目计划投资约 88.7 亿美元。

【芯海科技】9 月 2 日晚间，芯海科技发布关于拟变更募投项目实施方式的公告，公司计划用于募投项目场地投资的募集资金（共计 9,384 万元）的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所，购买土地、自建导致项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。公司科创板上市募集资金的投资项目为：（1）高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目；（2）压力触控芯片升级及产业化项目；（3）智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目。

【神工股份】8 月 23 日晚间，神工股份披露股东减持公告，公司股东计划集中竞价及大宗交易的方式减持合计不超过 2194.17 万股，合计不超过公司总股本的 13.71%。减持区间为 2021 年 9 月 14 日至 2022 年 3 月 11 日。

【斯达半导】8 月 24 日晚间，斯达半导披露股东减持公告，公司股东计划以集中竞价的方式减持公司股份数量合计不超过 160 万股，合计不超过公司总股本的 1%。减持区间为 2021 年 9 月 16 日起 6 个月内。

【兆易创新】8 月 30 日晚间，兆易创新披露股东减持公告，公司股东计划以集中竞价的方式减持公司股份数量合计不超过 2134 万股，合计不超过公司总股本的 3.21%。减持区间为 2021 年 9 月 24 日起 6 个月内。

【韦尔股份】8 月 30 日晚间，韦尔股份披露股东减持公告，公司控股股东计划以集中竞价的方式减持公司股份数量合计不超过 90 万股，合计不超过公司总股本的 0.91%。减持区间为 2021 年 9 月 23 日起 6 个月内。

【捷捷微电】8 月 31 日晚间，捷捷微电披露股东减持公告，公司高管计划以集中竞价的方式减持公司股份数量合计不超过 19.24 万股，合计不超过公司总股本的 0.0261%。

【雅克科技】9 月 2 日晚间，雅克股份披露股东减持公告，公司股东国家集成电路产业基金计划以集中竞价的方式减持公司股份数量合计不超过 462.85 万股，合计不超过公司总股本的 1%。减持将于公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行。

【聚辰股份】9 月 2 日晚间，聚辰股份披露股东减持公告，公司股东拟通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持不超过 241.68 万股公司股份，合计不超过公司总股本的 2%。减持区间为 2021 年 9 月 29 日起 6 个月内。

5 投资建议

建议持续关注半导体行业。2021 年度芯片市场需求强劲，供需失衡延续，半导体龙头公司全年营收上行具备确定性；国家政策支持叠加国产化替代加速，加快国内半导体产业技术研发进展，新技术领域国内龙头积极推进，产业长期发展向好具备确定性。给予半导体行业“增持”评级。

6 风险提示

晶圆代工企业产能扩产不及预期；市场需求不及预期，国内半导体企业技术研发进展不及预期；内外部宏观政策变化不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平准则出具本报告。本报告准确清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

湘财证券投资评级体系（市场比较基准为沪深 300 指数）

- 买入：**未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上；
- 增持：**未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%；
- 中性：**未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持：**未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 以上；
- 卖出：**未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上。

重要声明

湘财证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。

本研究报告仅供湘财证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告由湘财证券股份有限公司研究所编写，以合法地获得尽可能可靠、准确、完整的信息为基础，但对上述信息的来源、准确性及完整性不做任何保证。湘财证券研究所将随时补充、修订或更新有关信息，但未必发布。

在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或征价。本公司及其关联机构、雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。投资者应明白并理解投资证券及投资产品的目的和当中的风险。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告版权仅为湘财证券股份有限公司所有。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“湘财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。